

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于对外投资的进展暨以子公司股权提供质押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

因业务发展需要，2020年9月，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆两江新区管理委员会签署《投资协议》，在重庆两江新区管理委员会所管辖的直管区域内新增投资背光模组项目、研发中心项目。全资子公司重庆翰博显示科技有限公司（以下简称“重庆显示”）委托重庆两江新区管理委员会指定的重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（以下简称“水土公司”）代为建设背光模组项目和研发中心项目所需厂房，签署《代建协议》。项目代建的工程建设成本不超过2.75亿元，由水土公司先行出资，若项目工程建设成本超过2.75亿元，其超出部分由公司或重庆显示自行承担。

公司和重庆显示承诺以投资协议中所涉土地、厂房、设备（融资租赁方式采购的设备除外）及重庆显示和全资子公司重庆翰博显示科技研发中心有限公司（以下简称“重庆研发”）的股权作为上述厂房代建费用的抵押担保物，同时公司股东翰博控股集团有限公司（曾用名“合肥合力投资管理有限公司”）、合肥王氏翰博科技有限公司（曾用名“拉萨王氏翰博科技有限公司”）为厂房代建费用提供连带保证责任。

上述事项已经公司第三届董事会第二次会议及2020年第六次临时股东大会审议通过。具体详见公司分别于2020年9月28日、2020年10月13日披露于北京证券交易所官网（www.bse.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2020-155）《关联交易公告》（公告编号：2020-156）及《2020年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-162）。

二、质押标的公司基本情况

1、重庆翰博显示科技有限公司

成立日期：2020年7月28日

注册地址：重庆市北碚区云汉大道117号附665号

法定代表人：向辉

注册资本：8,000万元

经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展，显示器件制造，电子元器件制造，电子专用材料制造，光电子器件制造，照明器具制造，半导体照明器件制造，模具制造，合成材料制造（不含危险化学品），劳动保护用品生产，特种劳动防护用品生产，物业管理，非居住房地产租赁，住房租赁，电子测量仪器销售，机械设备租赁，显示器件销售，照明器具销售，半导体照明器件销售，电子专用设备销售，模具销售，五金产品零售，五金产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有其100%股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2024年3月31日/2024年1-3月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度 (经审计)
总资产	433,948,325.77	469,907,541.88
负债总额	363,993,111.54	398,537,595.84
净资产	69,955,214.23	71,369,946.04
资产负债率	83.88%	84.81%
营业收入	1,559,757.62	3,832,803.58
净利润	-1,414,731.81	-1,687,617.86

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：重庆翰博显示科技有限公司不是失信被执行人。

2、重庆翰博显示科技研发中心有限公司

成立日期：2020年7月31日

注册地址：重庆市北碚区云汉大道117号附664号

法定代表人：向辉

注册资本：6,000万元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；显示器件制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；光电子器件制造；半导体照明器件制造；其他电子器件制造；显示器件销售；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有其100%股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2024年3月31日/2024年1-3月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度 (经审计)
总资产	109,082,977.46	112,374,583.33
负债总额	34,290,296.34	35,912,575.00
净资产	74,792,681.12	76,462,008.33
资产负债率	31.44%	31.96%
营业收入	501,410.52	8,683,359.96
净利润	-1,669,327.21	10,085,884.45

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：重庆翰博显示科技研发中心有限公司不是失信被执行人。

三、进展情况

截至本公告日，上述项目已完成主体厂房建设、净化装修和机电设备安装调试，水土公司已按《投资协议》和《代建协议》要求向相关参建单位代为支付工程建设款。

公司、重庆显示及水土公司于2024年5月13日签署《股权质押协议》。公

司在重庆显示及重庆研发注册地市场监督管理局办理完成了股权质押登记手续，于近日领取并向质权人移交登记机关核发的就该等质押股权出具的股权质押登记凭证。

1、出质股权所在公司：重庆翰博显示科技有限公司

出质股权数额：8000 万元

出质人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

质权人：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

2、出质股权所在公司：重庆翰博显示科技研发中心有限公司

出质股权数额：6000 万元

出质人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

质权人：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

四、对公司的影响

公司本次以全资子公司重庆显示和重庆研发的 100%的股权作为质押，是为担保前期《投资协议》和《代建协议》所涉债务的履行，公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次以子公司股权提供质押担保不会给公司带来重大的财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日